

杭州晶华微电子股份有限公司

2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，基于对公司未来发展的信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况等，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半年主要进展及成效情况报告如下：

一、多措并举齐发力，助推公司高质量发展

1、聚焦主业，不断提高核心竞争力

公司围绕战略方向，专注于主营业务的深耕细作，持续重视研发投入，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。2024 年上半年公司研发费用 3,227.86 万元，同比下降 1.78%，研发投入占营业收入的比例为 53.65%。

2024 年上半年，公司重点推出了带 HCT 功能的血糖仪专用芯片。该芯片是专为带 HCT 功能的血糖仪产品而设计的 SoC 器件，血糖测量精度满足 ISO15197:2013 规范。2024 年三季度，公司正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片，分别为支持 6-10 串电池组的 SDM9110，以及支持 10-17 串电池组的 SDM9117，可应用于电动工具、平衡车、扫地机器人、电动旋翼机、电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能等场景。

报告期内，在持续研发投入的保障下，研发项目亦有序开展：3MHz,300uA 低噪声 CMOS 运放芯片、低功耗零漂移轨到轨运放芯片、低噪声轨到轨运算放大器芯片、16 位 8 通道 250kSPS SAR-ADC 芯片和内置 Vref 的超小型低功耗 16 位 ADC 芯片等已达量产阶段；带有高精度 ADC 及 8051 MCU 的高性价比智慧健康测量 SOC 芯片、40V 高压低功耗运算放大器芯片、18V 高压低功耗轨到轨运放芯片等已处流片阶段；低功耗零失调轨到轨仪表放大器芯片、16 位多通道中速 SAR-ADC 芯片和高性价比低压差电压调整器芯片等已在验证阶段。此外，

公司积极布局电池管理芯片系列产品，已启动多个研发项目，将扩充公司 BMS 产品线，进一步提升市场竞争力。

2、提高市场占有率，优化供应链管理

报告期内，公司根据市场环境和竞争格局的变化，积极主动优化销售策略，把握市场行情，增强市场竞争力。就医疗健康 SoC 芯片产品，公司血压算法已趋成熟，4G 血压计方案已经开始出货，同时公司积极布局带 HCT 功能的血糖仪专用芯片销售渠道，已推广至相关知名品牌客户；就工业控制芯片产品，公司配合芯片特性，优化软硬件设计，并基于客户应用需求，提供稳定和可靠的自动化测试系统，通过不断满足客户需求及完善解决方案，积极抢占市场份额。同时，公司进一步加强与现有供应商的协从合作，持续强化产能保障，确保供应链长期安全稳定，以保障业务的连续性和高效运转。

3、把握机遇，积极探寻外延式发展

国内半导体行业并购活跃，中国集成电路产业正在通过并购加速资源整合和技术创新。公司充分发挥上市公司平台的优势，在稳固内生业务发展的基础上，以主营业务为核心，积极探索通过并购整合适合的标的，在充分考量业务协同性和技术创新性的前提下，重点关注同行业或集成电路产业链上下游具有关键核心技术的企业，从技术互补或市场扩张等方面提升业务规模和竞争力。

二、提升公司治理水平，筑牢规范运作根基

公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理机构，提高治理效能。公司已邀请律师事务所组织对新《公司法》的专项学习宣传活动，深入研读新《公司法》的立法宗旨与精神，确保对其有深刻的理解与把握，同时，公司已在核对现有内部控制制度的有效性，后续将及时召开董事会、监事会或股东大会，对公司的《公司章程》及相关制度进行修订和完善，确保公司内部控制的合规有效。此外，公司积极深化独立董事履职机制，加强与独立董事汇报沟通，邀请独立董事在现场指导工作，为独立董事履职提供一切便利条件，保障独立董事履职权力。

公司积极组织董监高及相关工作人员参与证监会、交易所和各级上市公司协会等举办的培训，不断提升其专业素养和合规意识，以推动公司董监高尽职履责。报告期内，公司已组织部分董监高参加上市公司董事、监事和高管初任培训、辖

区上市公司独董专题培训和上市公司高质量发展并购重组实务专题培训，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性。

三、以投资者利益为核心，积极稳定持续回报投资者

公司始终坚持投资者利益至上原则，并已建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，充分保障全体股东的基本权益。在综合考虑公司实际情况、发展战略以及行业发展趋势的基础上，并且符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东利益，让投资者切实享受公司发展成果，提升广大投资者的获得感。

公司分别于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。2022 年度，公司以总股本 66,560,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 9,984,000.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.13%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-20,350,966.15 元。公司分别于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,414,389 股，转增后公司总股本增加至 92,974,389 股。

2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股（2023 年年度权益分派后调整为不超过人民币 42.95 元/股），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 7 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 576,760 股，占公司目前总股本的 0.6203%，回购最高价格为 43.64 元/股，回购最低价格为 18.37 元/股，回购均价为 38.09 元/股，使

用资金总额 21,971,556.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将结合实际情况、发展战略规划和行业发展趋势，为投资者提供持续、稳定的利益回报，提振市场信心，并将继续优化股东回报机制，让投资者切实享受公司发展成果。

四、重信披、多渠道，加强与投资者的沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持诚信原则，认真履行信息披露职责，并积极拓宽与投资者的沟通渠道，以建立良好的互动关系，切实维护投资者的合法权益。

报告期内，公司进一步加强信息披露的合规性，持续完善各部门间的重大信息内部报告管理体系，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，也借助新媒体平台工具，在合规范围内传递公司经营情况和技术创新等信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的广泛性和平等性。报告期内，公司通过“上证路演中心”平台参加了 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。除此之外，公司组织、参加了近 10 场次的投资者沟通交流活动，并通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式，加强与投资者交流的力度与频次。

公司将继续积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，输出内在价值，让投资者更全面、深入地了解公司的经营状况与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持。

五、构建利益共同体，强化管理层与股东利益共担共享

报告期内，公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产等方面与公司保持独立，不存在侵占公司资产、损害公司利益的情况。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高的合规意识和履职能力，通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。同时，公司根据经营情况、董监高所担任的职务、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定 2024 年度董监高薪酬方案，在审议 2024 年度董监高薪酬议案时，关联人员已按照相关规则对议案回避表决。

此外，2023年6月公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对公司管理层及核心骨干共计104位员工授予126.75万股限制性股票。报告期内，公司持续关注2023年限制性股票激励计划涉及考核要求的实现情况，将按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，有效地将股东利益、公司利益和管理层、核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

后续公司亦将结合年度财务状况、经营业绩等目标，对公司关键核心员工实施长效激励计划，同时，不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

六、其他事宜

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的主要内容均在有效实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2024年8月31日